

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司募集资金具体运用情况

深圳证券交易所：

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,873.0606 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	先进电子功能材料基地建设项目	34,043.20	34,043.20
2	深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目	22,989.98	22,989.98
3	营销服务网络及总部基地建设项目	10,006.00	10,006.00
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
5	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,039.18	122,039.18

（一）先进电子功能材料基地建设项目

1、项目投资概况

项目投资概况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	16,709.61	49.08%
2	机器设备	9,239.00	27.14%
3	铺底流动资金	8,094.59	23.78%
项目总投资		34,043.20	100.00%

2、项目进度安排

项目预计 36 个月建设实施完成，分为项目筹备、工程实施、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、项目投产等各阶段，具体实施进度如下表所示：

项目实施 内容	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备												
工程实施												
设备采购及 安装调试												
人员招聘及 培训												
项目投产												

3、项目选址情况

项目实施地点位于广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期），公司拟租赁和购置厂房设施项目，其中租赁面积为 15,000 平方米，购置面积为 6,000 平方米。

4、项目环保情况

在项目实施过程中，公司将严格执行《中华人民共和国环境保护法》及其他环保法律法规的有关规定，“三废”排放达到国家规定的排放标准。本行业不属于重大污染行业，项目运营过程产生的污染物主要为废水、废气和固废。项目产生的污染物较少，对环境不构成较大负面影响，符合项目所在地规划，经环保处理后，可达到环保要求，对周围环境无污染影响。

（二）深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目

1、项目投资概况

项目投资概况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	7,373.60	32.07%
2	研发软硬件	8,686.38	37.78%
3	研发费用	6,930.00	30.14%
	项目总投资	22,989.98	100.00%

2、项目主要研发课题

序号	研发课题	内容概述
1	高性能碳基导热垫片研发	在本研发课题中，公司将基于定向石墨烯垂直取向技术，开发具有更高导热系数、超低热阻和优异压缩性能的导热垫片。通过石墨烯片层垂直排列形成连续热传导通道，突破传统硅胶垫片的性能瓶颈
2	高导热高回弹绝缘垫片研发	在本研发课题中，公司将开发兼具高导热、高回弹、高体积电阻率以及耐温范围大的绝缘型垫片，通过氮化硼-氧化铝复合填料与柔性聚氨酯基体的协同设计，解决传统绝缘材料无回弹导热低的问题
3	高导热高挤出凝胶研发	在本研发课题中，公司将聚焦于开发适用于自动化产线的高导热、高流动性凝胶材料，具备优异的挤出成型性能，可在复杂曲面或不规则间隙中实现无气泡填充，具备高导热系数、高挤出速率以及低 BLT 的性能指标。满足高功率 LED、智能穿戴设备、5G 射频模块等精密电子器件对高效散热与工艺适配性的双重需求
4	高性能液态金属片研发	在本研发课题中，公司将基于钢基合金材料，开发一种常温为固态、受热后表面发生相变并具备自修复能力的液态金属热界面材料。通过材料配方与封装结构创新，实现高导热系数、低接触热阻以及宽相变温度范围等，适用于 5G 射频模块、毫米波雷达等高频振动场景下的高可靠性散热需求
5	高性能导热相变材料研发	在本研发课题中，公司将聚焦于开发具有高导热系数、相变温度幅度大、低热阻、抗泵出可靠性强、热响应可控的高性能导热相变材料，面向高功率芯片、5G 射频模块、服务器模块等高端电子设备的热管理需求。项目将突破传统相变材料在热循环和机械振动下易发生“泵出失效”的行业痛点，满足国产高端导热材料自主可控需求
6	高导热吸波材料研发	在本研发课题中，公司将持续致力于开发高导热、高频、宽频电磁吸波一体化材料，面向 5G 通信、毫米波雷达、智能驾驶系统等高电磁干扰环境下的热-电磁协同管理需求。项目将突破当前吸波材料导热性能差、频段窄、厚度大等瓶颈，满足高端电子设备对电磁兼容与高效散热的双重需求
7	高性能散热器及系统研发	在本研发课题中，公司将围绕高功率密度电子设备（如 5G 基站、AI 服务器、智能驾驶芯片、工业电源、激光器等）的高效散热需求，系统性开发高性能散热器器件与智能热管理系统，聚焦开发 3D 相变散热器，基于三维毛细结构设计、相变传热机制、异形结构成型工艺，实现高热流密度场景下的高效、轻量化、自适应散热等功能。该散热器采用封闭式腔体结构，通过腔体内工质的蒸发-冷凝循环，实现热量的快速扩散与均热
8	高导热屏蔽泡棉研发	在本研发课题中，公司将基于石墨烯的高导热和高导电性能，开发一种同时具备高屏蔽效能和导热性能的石墨烯泡棉，其具备高导热系数、高屏蔽效能、低阻抗等优秀性能。产品不仅可以适应不规则的缝隙填充，还能同时解决高功率芯片的屏蔽与散热需求，突破了当前泡棉的导热性能差、厚度大等瓶颈，满足高功率芯片贴合的严格要求
9	高回弹阻燃性 SMT 导电泡棉研发	在本研发课题中，公司将聚焦用于表面贴装技术（SMT）流程设计的高性能导电材料，产品性能方面，其具备低表面电阻、高回复率、屏蔽效能高以及阻燃性为 UL94V-0 等优秀性能。产品具备多次回流焊耐受能力与优异回弹性双重核心优势，完美适配电子制造领域的严苛工艺需求
10	高阻燃性吸波泡棉研发	在本研发课题中，公司将致力于开发阻燃-吸波一体化复合海绵材料，面向 5G 基站天线罩、新能源汽车毫米波雷达、智能驾驶系统等高电磁干扰环境下的电磁兼容与阻燃安全协同管理需求。同时，通过水性涂层-闭孔化改性工艺创新，突破传统吸波材料掉粉严重、吸潮性能衰减、环保合规性不足等瓶颈，满足高端电子设备对电磁屏蔽与消防安全的双

序号	研发课题	内容概述
		重严苛要求

3、项目进度安排

项目建设期为 18 个月，课题研究运行期 36 个月。项目实施内容分为项目筹备、场地购置及装修工程、软硬件订货及安装调试、人员招聘、开展研发等各阶段，具体实施进度如下表所示：

项目实施内容	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备												
场地购置及装修工程												
软硬件订货及安装调试												
人员招聘												
开展研发												

4、项目选址情况

项目实施地点位于广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期），公司拟购置厂房实施本项目。

（三）营销服务网络及总部基地建设项目

1、项目投资概况

本项目投资概况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	5,943.00	59.39%
2	设备投资	1,343.00	13.42%
3	人员投入	1,460.00	14.59%
4	营销推广投入	1,260.00	12.59%
项目总投资		10,006.00	100.00%

2、项目进度安排

本项目建设期为 36 个月，分为项目筹备、场地购置、租赁与装修、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行等各阶段，具体实施进度如下表所示：

项目实施内容	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备												
场地购置、租赁与装修												
设备购置及安装调试												
人员招聘及培训												
试运行												

3、项目选址情况

本项目拟购置场地建设深圳总部，并计划在国内外重点城市租赁场地建设 5 处区域营销服务中心。总部选址为广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）。

（四）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的 25,000.00 万元用于补充流动资金。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司生产经营所需的流动资金持续增加。公司将根据业务发展进程安排该部分资金投放的进度和金额，主要用于主营业务。

（五）发展与科技储备资金

公司拟募集发展与科技储备资金 30,000.00 万元，为未来开展前瞻性研发以及产业链并购与股权投资储备资金。公司将围绕战略规划和发展目标，结合业务经营的实际情况，合理、有序、高效地使用发展与科技储备资金，持续提升公司核心竞争力和盈利能力。

特此说明。

本页无正文,为《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司募集资金具体运用情况》
之签章页

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

2016年9月8日

